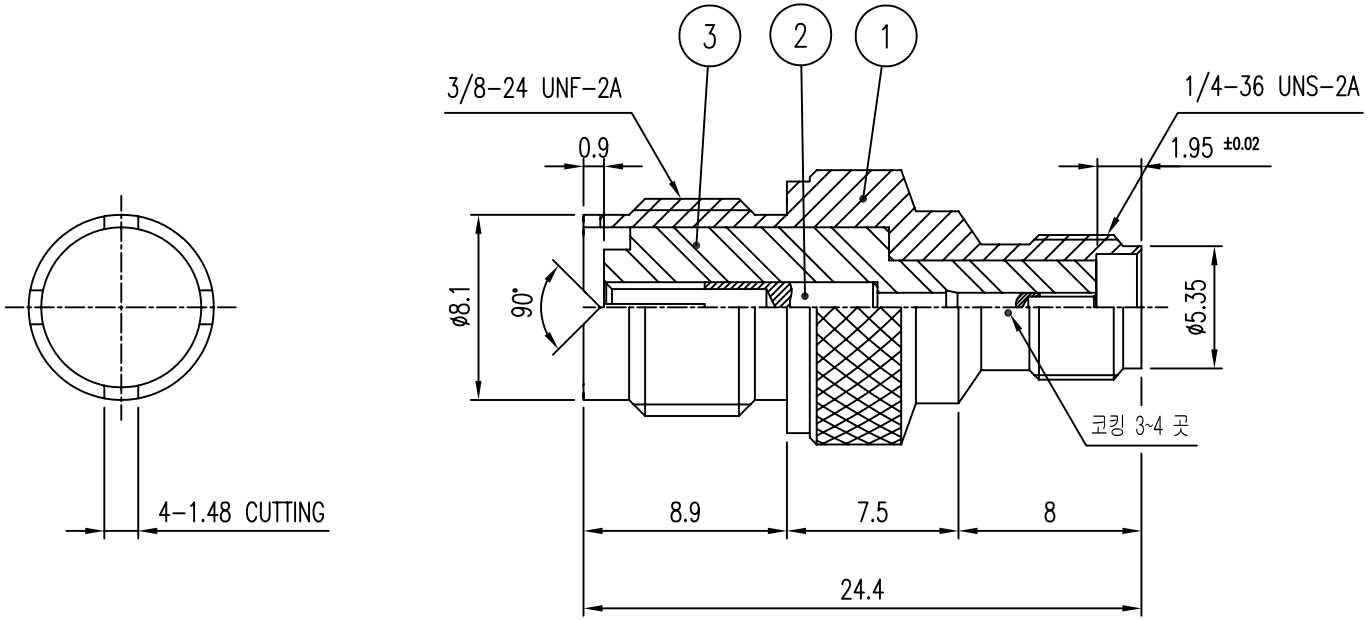
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



주 기

1. 코킹부위 3곳 작업 할 것.

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
3	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00044-N/1 (HA213)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate (1.27μm)	DAC00073-5/1 (EA243)
1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate	DAD00083-5/1 (DA280)

대체가능재질

공통공차 소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2005. 9. 14.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 NS 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMAJ-MINI UHFJ VER.0

A4

도번 AD00228-7/1

K361-171-000